

상 세 규 격 서

1. 품목번호 Item. No			
2. 품명 COMMODITY	한글 : 2차원 에피 웨이퍼		
	영문 : 2d epi wafer		
3. 수량 Q'ty	4	4. 단위 Unit	EA
5. 물품분류번호	12141911	6. 납품일수	계약후 30일 이내
7. 납품장소	본부동 레이저연구센터장 (A180800)	8. 인도조건	현장설치도
9. 대금지급	검수완료후 100%	10. 공동계약여부	불가
※ 아래 항목에 대하여 적정여부를 선택하여 주십시오.			
11. 규격검토	특정업체 및 특정규격 여부 : 불필요		
12. 입찰참가 자격	별도의 자격이나 면허 필요 여부 : 불필요		
13. 국내제작 가능여부 등	1. 국내 제작 가능 여부 : 가능 2. 외국산의 경우 대리점 존재여부 : 해당사항 없음 3. 국내 재고 보유 여부 : 미보유		
구 분	상세명세		
1.적용범위	본 상세 규격서는 2d vertical heterostructure 성장이 가능하도록 표면마감처리가 된 2인치 MoS2, WS2 wafer 적용한다.		
2.일반사항	2.1 물품용도 본 물품은 2d vertical heterostructure 성장이 가능하도록 표면마감처리가 된 2인치 IMoS2, WS2 wafer 로써 다음과 같은 항목을 포함해야 한다. 1) Size : 2인치 2) 기판 타입 : 사파이어(0001) 3) 제작방법웨 : LPCVD 2.2 공급의 범위 본 물품의 공급 범위는 다음과 같다. 1) 2d epi wafer (MoS2: 2EA) ○ Size : 2inch ○ Substrate type : Sapphire (0001)		

상세규격서

- Coverage : MoS2
- Direct bandgap excitonic semiconductor
- Hexagonal phase
- 2) 2d epi wafer (WS2: 2EA)
 - Size : 2inch
 - Substrate type : Sapphire (0001)
 - Coverage : WS2
 - Direct bandgap excitonic semiconductor
 - Hexagonal phase

2.3 공급자의 책임

2.3.1 납품

- 1) 납품 일수 : 계약일로부터 30일 이내로 하며, 납품 후 검수가 완료된 시점을 납품완료일로 한다.
- 2) 납품장소: 한국광기술원 레이저연구센터장(본부동 8층 A180800)
- 3) 인도조건: 본 제품은 밀봉상태로 납품함을 원칙으로 한다.

2.3.2 검수 및 기술지원

1. 물품검수

- 1) 물품검수는 물품 납품 후 검수를 실시한다.
- 2) 공급자는 한국광기술원 검수자 입회하에 검수자가 지정하는 방법으로 검수를 수행한다. (본 상세규격서 4. 검수 및 시험 참조)

2.3.3 하자보증

- 1) 하자보증기간은 최종 검수가 완료된 후 1년으로 한다.
- 2) 하자보증기간 내에 하자가 발생한 경우에는 무상으로 수리 또는 교체하여야 하며, 수리 또는 교체한 부분의 하자 보증기간은 교체한 날로부터 1년 이상으로 한다.

2.3.4 기타

상세규격서

1) 본 상세규격서의 해석상의 이견이 있을 경우에는 상호협의를 따른다.

3. 기술사양

3.1 물품(모듈)규격

3.1.1 세부사양 및 성능

1) 2d epi wafer (MoS₂:)

- Size : 2inch
- Substrate type : Sapphire (0001)
- Coverage : MoS₂
- Direct bandgap excitonic semiconductor
- Hexagonal phase

* 주문수량: 2EA

2) 2d epi wafer (WS₂: 2EA)

- Size : 2inch
- Substrate type : Sapphire (0001)
- Coverage : WS₂
- Direct bandgap excitonic semiconductor
- Hexagonal phase

* 주문수량: 2EA

4.검수 및 시험

4.1 물품 입고 후 검수

다음 항목에 대하여 검수를 실시하여 검수기준을 만족하여야 하며, 이상이 있을 경우 하자로 판정한다.

4.1.1 검수 항목

- 1) 세부 사양 납품 확인
- 2) 기본 작동 확인

4.1.2 검수기준

상 세 규 격 서

순서	검수 항목	검수 방법
1	세부 사양 납품 확인	· 물품 크기 및 개수
2	기본 기술 사양 확인	· 웨이퍼 표면 및 ORIENTATION 확인

5. 제출서류

5.1 납품 시 제출서류

공급자는 다음의 내용을 포함한 스펙시트 1부를 제출하여야 한다.

- 1) 물품 기술사양